

STARK IN IOT

von Erik Schäfer: Auf der embedded world in Nürnberg sprach K&E mit Dr.-Ing. Klaus-Peter Dyck, Senior Manager Marketing & Application bei Fujitsu Electronics Europe. Was genau kann sein Unternehmen Kunden in Deutschland anbieten?

Herr Dr. Dyck, was genau kann Fujitsu Electronics Europe seinen Kunden in Deutschland als ein „Value Added Distributor“ (VAD) anbieten?

DR. KLAUS-PETER DYCK: Unsere Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb geht hier in zwei Richtungen. Einmal bemühen wir uns in der Hauptsache mit Herstellern zusammenzuarbeiten, durch deren Produkte wir unseren Kunden eine besondere technische Lösung anbieten können.

Zum andern haben wir ein Team von Applikations-Ingenieuren (AE) aufgebaut, das in der Lage ist, basierend auf diesen Produkten mit den Kunden die beste Lösung zu entwickeln. Das geht oft nicht mit Produkten von der Stange. Deshalb bieten viele unserer Hersteller auch die Möglichkeit, kundenspezifische Lösungen zu entwickeln.

Nun geschehen neue Entwicklungen heute oft gemeinsam mit den Kunden. Inwieweit können Sie in Deutschland das notwendige Engineering anbieten?

Mit den AE können wir natürlich nur begrenzt wirkliches Engineering betreiben, aber in vielen Fällen reicht das Know-how, das wir auf diese Weise einbringen können, dem Kunden schon wesentlich weiter. Wenn das nicht ausreichend ist reden wir mit einer ganzen Reihe von Partnern, die das Projektteam mit ihren Ressourcen verstärken können.

Eine japanische Muttergesellschaft kann erfahrungsgemäß Entscheidungszeiträume ausdehnen. Wie können Sie trotzdem schnell agieren, wenn es Ihren Kunden unter den Nägeln brennt?

Das sagt man japanischen Unternehmen nach, aber auch hier unterscheiden wir uns signifikant, da wir sehr selbständig agieren können, wobei man sich auch hier – und auch das sagt man im Positiven Japanern nach – auf die Entscheidung und Kosteneinschätzungen verlassen kann. Durch die AE-Mannschaft und die dadurch aufgebaute lokale Produktexpertise versuchen wir zudem, Probleme so früh als möglich zu identifizieren und an den Kunden zu kommunizieren, da wir gerne ehrlich und auf Augenhöhe mit unseren Kunden und Partnern kommunizieren. Dabei hilft auch, dass uns unsere Muttergesellschaft eher an der lange Leine laufen lässt. Wenn es am Ende auf eine kundenspezifische Lösung hinausläuft, ist natürlich die Abstimmung mit von uns gestelltem Projektmanagement selbstverständlich.

**Klaus-Peter Dyck,
Senior Manager Marketing & Application**

»So stellen wir zum Beispiel fest, dass Kunden sich vermehrt für Chips interessieren, die Hardware-Beschleuniger für die Verschlüsselung bereitstellen.«

Dr. Klaus-Peter Dyck
Foto: Erik Schäfer

Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Automobilbau, Industrie und Kommunikation. Wie sind diese Bereiche gewichtet?

Nach wie vor ist der Automobilbereich sehr stark, aber durch unser Produktportfolio sind wir sehr stark im Bereich IoT unterwegs. Präziser fokussieren wir uns auf den Sektor in dem Energieeffizienz eine entscheidende Rolle spielt. Im ersten Ansatz fallen einem hier Anwendungen ein, die man typischerweise aus dem Bereich der Wearables, also aus dem Consumer-Sektor kennt. Wir sehen IoT-Projekte und unsere Kunden aber überwiegend aus dem Industriebereich. Darüber hinaus gibt es verschiedene Ansätze auch in der Medizintechnik. Das Stichwort hierzu wäre Langzeitdatenerfassung.

Zum Industriesektor: Was sind in Richtung Maschinen- und Anlagenbau Beispiele für erfolgreiche Projekte mit deutschen Kunden?

Wenn Sie speziell auf den deutschen Maschinen- und Anlagenbau abheben, sind das sicherlich ASIC-Projekte, die wir an deutsche Kunden liefern. Daneben sind wir hier sehr erfolgreich mit unseren FRAM-Speichern. Generell ist mir aber die Zuspitzung allein auf den deutschen Markt zu eng. Nicht umsonst finden Sie „Europe“ in unserem Firmennamen. Aktuell bearbeiten wir Projekte, die quer durch Europa gehen.

Die Sicherheit – in dieser vernetzten Welt – findet verstärkt seinen Weg bereits auf die Platinen von embedded Systemen. Dies kann durch einen eigenen Sicherheits-Chip oder andere „Hardware-Anker“ geschehen. Inwieweit ist das Thema für Sie virulent?

Natürlich findet dieses Thema auch bei uns statt. So stellen wir zum Beispiel fest, dass Kunden sich vermehrt für Chips interessieren, die Hardware-Beschleuniger für die Verschlüsselung bereitstellen. Da wir relativ viele Projekte und Produkte im ultra low Power-Bereich haben, ist der notwendige Spagat zwischen möglichst guter Verschlüsselung und gleichzeitig niedrigster Leistungsaufnahme nicht immer trivial. Ein anderer Aspekt ist, dass es europäischen Kunden zum Teil auch um den Schutz vor Nachbauten geht. Hier wählen wir dann häufig den Ansatz, mehrere Chips zusammen mit passiven Komponenten in einem Package zu vereinigen. Das verhindert den Nachbau zwar nicht komplett, treibt den Aufwand da-

für aber durch die Verwendung von Chips ohne Package enorm in die Höhe, so dass er in vielen Fällen kommerziell nicht mehr attraktiv ist.

EMV-Verträglichkeit ist gerade bei immer kleiner werdenden Bauteilen eine Herausforderung. Inwieweit können Sie hier auch eigene Tests durchführen, um einen ausreichenden Schutz zu garantieren?

Zusammen mit unseren Produktionspartnern, die auch aus dem Fujitsu-Konzern stammen, können wir Kunden in Verbindung mit einer entsprechenden Produktion praktisch jede Messung, die zur Zertifizierung einer Baugruppe notwendig ist, anbieten.

Welche Situation treffen Sie häufiger an und welche Tendenzen sind hier auszumachen: Gilt es eher in vorgegebene Bauräume auch die Elektronik unterzubringen oder steigen Sie vermehrt bereits in der Projektphase ein?

Idealerweise sind wir bereits in der Projektphase involviert, weil eine Minimierung der Baugröße ohne den Austausch von Komponenten nur bedingt möglich ist. Wenn das Projekt beim Kunden schon sehr weit fortgeschritten ist, dann sind leider die Möglichkeiten begrenzt. Dennoch ist es natürlich häufig der Fall, dass die Entwicklung beim Kunden in Bezug auf die Hardware praktisch abgeschlossen ist und dann „nur“ nach Möglichkeiten gesucht wird, die Baugröße zu reduzieren. Insgesamt halten sich die Dinge bei uns aber die Waage. »

www.fujitsu.com/feeu

SNAP TELESCOPIC COVER

Die innovative und zerlegbare Schutzabdeckung



MULTI-STEEL

Faltenbalg mit Ecklamellen: die Barriere gegen Späne



MOTOR ROLL-UP COVER

Aufprallgeprüft nach EN 12417 mit Schürze der „J“-Serie



Protezioni
Elaborazioni
Industriali

www.pei.eu

Besuchen Sie uns auf der

EMO Hannover
18-23 · 9 · 2017